

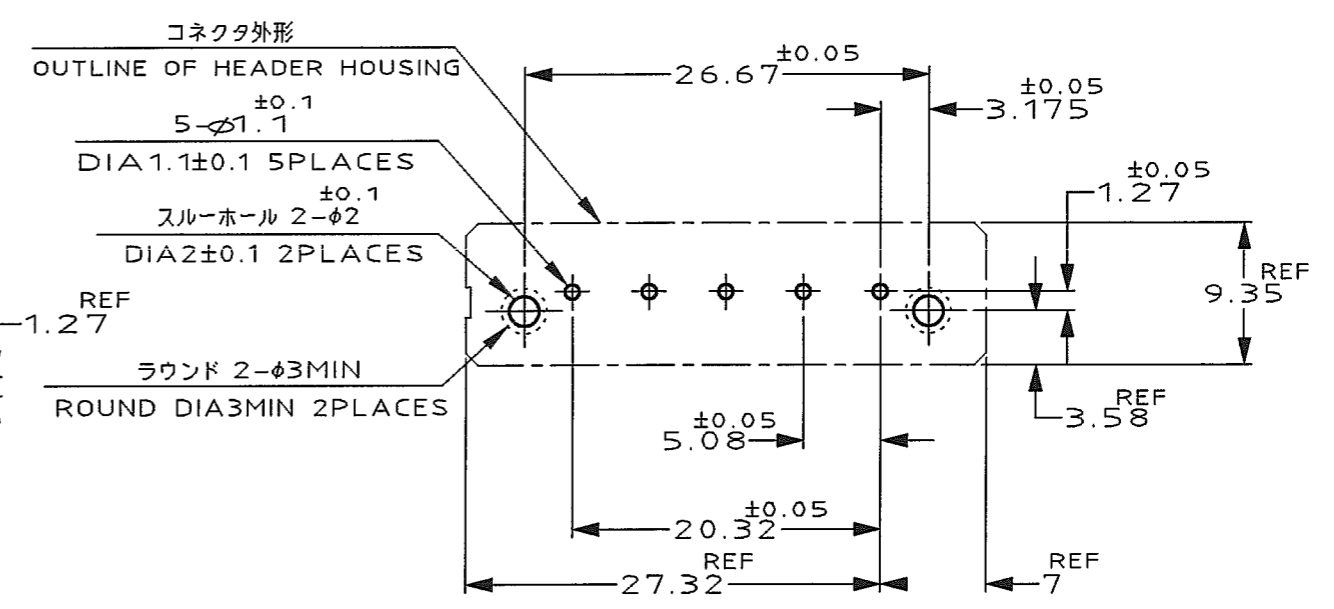
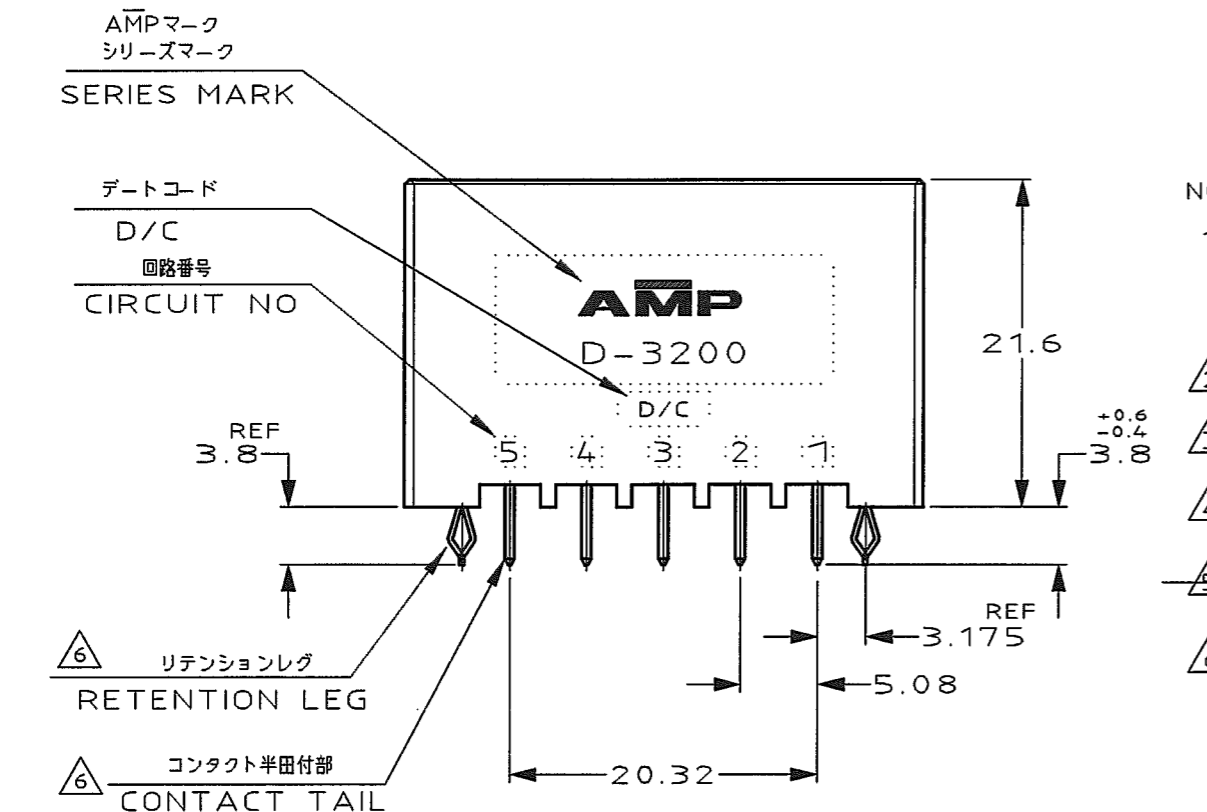
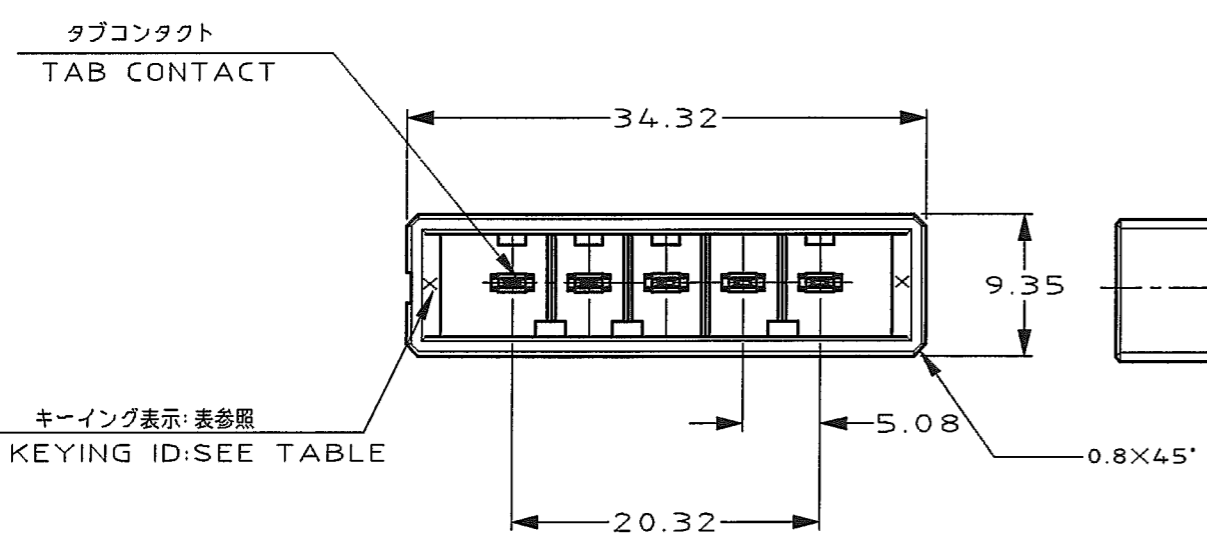
NUMBER 316132



METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER(94V-0), COLOR: BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
 contacts: 銅合金
 リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コントクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
- めっき: コントクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
- めっき: コントクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部
ニッケル下地の上に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部
ニッケル下地の上にスズめっき

	Y	△6 △4	2-316132-5
		△6 △3	2-316132-3
	X	△6 △2	2-316132-2
		△6 △4	1-316132-5
		△6 △3	1-316132-3
		△6 △2	1-316132-2

KEYING LOCATION				KEYING		FINISH		製品番号 PART NO.	
Copyright © 1995 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.									
WIRE RANGE				INSULATION DIA		NAME			
mm²(AWG -)				mmφ		ダイナミック D-3200S 5.08 ピッチ (V) 5 極 ヘッダーアセンブリー			
MATERIAL				FINISH		DYNAMIC D-3200S 5.08PITCH(V) 5 POS.HDR CONN.ASS'Y			
SEE NOTES				SEE NOTES		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)			
注記参照				注記参照		SIZE LOC NUMBER			
DR. 26/JUL/95				DE. 26/JUL/95		A3 J C=316132			
K.IKEDA				K.IKEDA		SCALE REV. SHEET			
2/AUG/95				2/AUG/95		2-1 B 1 OF 1			
Y.ISHIKAWA				S.MANABE					